

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 59/2024 "FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE TELECONTROL MODULAR PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P."

Pregunta 1: Hemos estado revisando la documentación que aparece en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid, y cotejando con la documentación escrita en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Licitación 59/2024, PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE TELECONTROL MODULAR PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P, se hace mención en dicho pliego, en el apartado 3.5 Módulo de alimentación secundaria, que el esquema de montaje está en el Anexo VII.

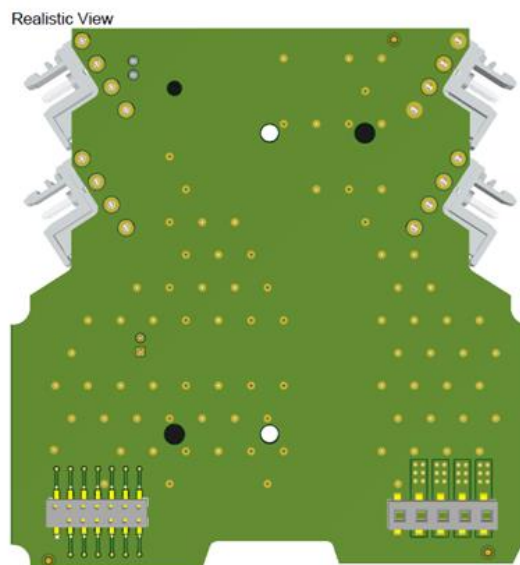
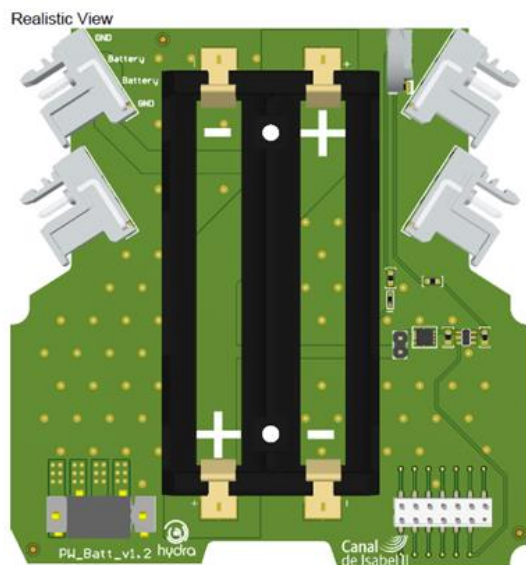
Pero dicho Anexo, corresponde al despiece de la envolvente.

Creemos que falta dicho Anexo del Módulo de alimentación secundaria.

Respuesta 1: Descripción módulo alimentación secundaria:

Layer Stack Legend						
Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber	
	Top Overlay			Legend	GTO	
Surface Material	Top Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GTS	
Copper	Top Layer	0.04mm		Signal	GTL	
Prepreg		1.48mm	FR-4	Dielectric		
Copper	Bottom Layer	0.04mm		Signal	GBL	
Surface Material	Bottom Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GBS	
	Bottom Overlay			Legend	GBO	
Total thickness: 1.57mm						

La placa contiene principalmente el soporte de las baterías LiFePo4, un led y un loadswitch TPS22917 para protección y los conectores externos.



*Junto con la publicación de la presente respuesta se publica en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el Anexo del del módulo de alimentación secundaria.*

Madrid 18 de diciembre de 2024